

(11) Publication number:

04-067839

(43)Date of publication of application: 03.03.1992

(51)Int.CI.

A61B 5/0245

(21)Application number: 02-180259

(71)Applicant: COLLEEN DENSHI KK

(22)Date of filing:

06.07.1990

(72)Inventor: HARADA CHIKAO

KAWAMURA NORIO NAKAJIMA RYUJI

TAKAHASHI ARIHIRO YAMAZAKI TOSHIMASA

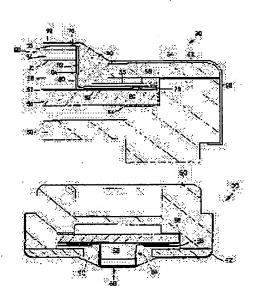
YASUI MASANOBU KONDO TATSUSHI

(54) CONTACT PRESSURE SENSOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To eliminate the influence on measurement accuracy by connecting the connecting terminals provided on the surface of a semiconductor chip and a substrate by using a flexible flat cable rising from the substrate along the side wall surface of a spacer member.

CONSTITUTION: The plural terminals (bumps) 76 provided on the surface of the semiconductor chip 66 and the plural terminals 78 of a circuit film 52 provided on one surface of a plate member 56 are connected by the so-called flexible flat cable 84 which has flexibility and in which many conductors 80 formed of copper foil at prescribed intervals are supported by a resin film 82 of, for example, polyimide, etc. The flexible flat cable 84 is disposed in the state of rising perpendicularly from the plate member 56 along the side wall surface of the spacer 58. The pressing reaction from the skin is substantially prevented from being acting on the flexible flat cable 84.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

Best Available Copy

®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平4-67839

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)3月3日

A 61 B 5/0245

8932-4C A 61 B 5/02

310 K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

公発明の名称 接触圧センサ

②特 顧 平2-180259

②出 顧 平2(1990)7月6日

愛知県小牧市林2007番1 コーリン電子株式会社内 @発 明 者 親 男 原 \blacksquare 愛知県小牧市林2007番1 コーリン電子株式会社内 紀 夫 **20発 明** 者 河 村 愛知県小牧市林2007番1 コーリン電子株式会社内 ②発 者 中 嶋 隆 明 愛知県小牧市林2007番1 コーリン電子株式会社内 有 橋 裕 @発 明 者 高 愛知県小牧市林2007番1 コーリン電子株式会社内 個発 明 者 Ш 崎 敏 Œ コーリン電子株式会社内 愛知県小牧市林2007番1 明 者 安 井 正 伸 個発 達志 コーリン電子株式会社内 愛知県小牧市林2007番 1 明者 近 藤 ②発 愛知県小牧市林2007番1 コーリン電子株式会社 顧 の出 四代 理 人 弁理士 池田 治幸 外2名

明細書

1. 発明の名称 接触圧センサ

2. 特許請求の範囲

表面に圧力検出素子が配設された半導体チップと、該半導体チップを裏面から支持するスペーサ 部材と、該スペーサ部材が固定される基板とを備え、前配半導体チップの表面が被測定圧を発生する対象物に向かって押圧されて接触圧力を検出するための接触圧センサにおいて、

前紀半導体チップの表面に設けられた接続選子と前記基板との間を、前記スペーサ部材の側壁間に沿った状態で該基板から立ち上がるフレキシブルフラットケーブルを用いて接続したことを特徴とする接触圧センサ。

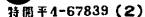
3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は被制定圧を発生する対象物に押圧されて、その対象物との間の接触圧を検出する為に用いられる脈波センサに関するものである。

従来の技術

被測定圧を生じる対象物が押圧されて、その対 象物との間の接触圧を検出する接触圧センサが提 案されている。たとえば、生体の皮膚直下の動脈 に発生する圧脈波を非観血的に検出するためにそ の動脈の真上を皮膚上から押圧する際に用いられ る原波センサがそれであり、本出願人が先に出願 した特顧平1-151106号や特顧平2-41 050号に記載されている。生体の動脈内におい て周期的に発生する圧力変動波、すなわち圧脈波 は血圧値だけでなく循環器の作動状態を反映して いることから、血圧値の測定あるいは循環器の診 斯などのために生体動脈内の圧脈波を非観血的に 検出することが望まれるため、上記のような接触 圧センサが用いられるのである。このような形式 の接触圧センサにおいては、通常、生体に装着さ れるハウジング内に設けられ、表頭に圧力検出素 子が配設された半導体チップと、その半導体チッ プを裏面から支持するスペーサ部材と、そのスペ ーサ部材が固定される基版とを備え、上記半導体



チップの表面が生体の表皮下に存在する動脈に向 かって押圧され、動脈内の圧力振動である圧脈液 が検出されるようになっている。

発明が解決すべき課題

ところで、上記のような従来の接触圧センサで は、半導体チップと基板との間は可提性シートに 支持された複数本の消状配線、すなわちフレキシ ブルフラットケーブル(FFC)により接続され る。この場合、半導体チップの表面に配列されて いるパンプと基板上の所定の接続端子のフレキシ ブルフラットケーブルは、それらバンプと接続端 子とを結ぶ斜めの線に沿った状態とされる。しか し、圧脈波検出中における皮膚からの押圧反力が 上記フレキシブルフラットケーブルに作用したり、 或いは温度変化による基板の反りやフレキシブル フラットケーブル自体の収縮が発生すると、その フレキシブルフラットケーブルの一端が接続され ている半導体チップに直接応力が伝達されて半導 体チップに歪が発生し、圧力検出が不正確となっ て特度が低下する不都合があった。

実施例

以下、本発明の一実施例を図面に基づいて詳細 に説明する。

第2図および第3図は本発明が適用された脈波 検出用プローブの一例を示す図であって、10は ハウジングである。ハウジング10は、全体とし 本発明は以上の事情を背景として為されたものであり、その目的とするところは、皮膚からの押 圧反力が加えられたり、或いは温度変化があった としても、測定精度が影響されない脈波センサを 提供することにある。

課題を解決するための手段

作用および発明の効果

このようにすれば、フレキシブルフラットケーブルがスペーザ郁材の側壁面に沿って基板から立

て容器状を成し、後述の手首34側において関口 する第1ハウジング12と、ピン14により第1. ハウジング12に回動可能に連結された第2ハウ ジング16とから構成されている。第1ハウジン グ12内には、容器状を成し、手首34側におい て開口するケーシング18が、それに一体的に設 けられた一対のアーム部20、22において、図・ 示しない送りねじおよび案内ロッドにより第2図 および第3関中左右方向の移動可能に設けられて いる。また、第1ハウジング12内には、図示は しないが、前記送りねじの第2ハウジング16側 に位置する端部と作動的に連結する被連ギヤユニ ットが設けられており、その減速ギャユニットは 第2ハウジング16内に設けられた図示しない電 動モータの出力軸と可挠性カップリング(図示せ ず)を介して作動的に連結されている。これによ り、第1ハウジング12および第2ハウジング1 6間の回動角度に拘わらず、電動モータの駆動力 が減速ギャユニットを介して送りねじへ伝達され るようになっている。

上記ケーシング18内にはダイヤフラム24が 設けられており、これにより、ケーシング18内 の底部側に圧力室(図示せず)が形成されている。 ダイヤフラム24の前配圧力室側と反対側の面に は、押圧面26にたとえば複数の感圧素子28が ケーシング18の移動方向に沿って配列された脈 波センサ30が固着されており、脈波センサ30 は、前配圧力室内の圧力に応じてケーシング18 および第1ハウジング12内から突き出されるよ うになっている。

上記第1ハウジング12にはバンド32が一端 部において取り着けられており、ハウジング10 をたとえば手首34の表面上に配設し、その手首 34を巻回したバンド32の他端部側をファスナ 36を介して第1ハウジング12の底部外面に係 止することにより、ハウジング10が手首34の 表面に装着されるようになっている。このとき、 脈波センサ30の窓圧素子28の配列方向は、手 首34の皮膚直下にある橈骨動脈35と略直の る方向に位置している。そして、図示しない制御

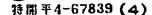
酉54を介してこのセンサヘッドケース50の中 央凹部内に固定されるセラミック製の板部材 5 6 と、この板部材56の中央部に固定された直方体 状のスペーサ58と、このスペーサ58に接着さ れたセンサチップ60と、回路膜52やその接続 部分を保護するためにセンサヘッドケース50に 接着された金属製の保護プレート62などを構え ている。上記スペーサ58は、電気的絶縁体とし て取り扱われ得るように少なくとも表面が絶縁処 理された物質、たとえばプラスチックやアルマイ ト処理されたアルミニウムが用いられる。上記国 路膜52が固着された板部材56は、センサチッ プ60から外部の測定装置本体に至る電気的接続 の中継回路であり、必要に応じてマルチプレクサ、 プリアンプ、レギュレータなどの能動素子が設け られると同時に、センサチップ60を機械的に支 持するための部材としても機能しているものであ り、請求の範囲の基板に対応している。

上記センサチップ 6 0 は、第 5 図の斜視図に示すように、ガラスなどの比較的開性の高いバック

装置により、前記圧力室の圧力を図示しない調圧 装置を介して調節するとともに前記電動モータを 駆動し、緊波センサ3-0を動脈上に位置決めして-最適感圧素子をおよび最適押圧力を決定した後、 その最適押圧力において最適感圧素子から出力さ れた脈波信号に基づいて脈波が検出されるように なっている。なお、第1ハウジング12の開口側 の韓面には、長手状を成す一対のスポンジ38. 40が固着されており、第1ハウジング12はス ポンジ38.40において手首34の表面に接触 させられるようになっている。スポンジ38,4 0の手首34との接触面には、両面粘着シート4 2. 44がそれぞれ固着されている。これにより、 第1ハウジング12は両面粘着シート42、44 の粘着力に基づいて手首34の表面に固着される ようになっている。

第4図に詳しく示すように、上記脈波センサ3 0は、前記ダイヤフラム24の中央部に固定されるプラスチック製のセンサヘッドケース50と、 回路膜52が一面に固着され、他面において接着

アップ版64と、このパックアップ板64の一面 に接着されたシリコン単結晶板等から成る半導体 チップ66とから構成されている。スペーサとし ても機能する上記バックアップ板64には、スペ ーサ58および板部材56の中央穴(図示せず) を通して半導体チップ66の裏面(非押圧側の面) に大気圧を導くための図示しない2本の貫通穴が 設けられている。上記半導体チップ66は、300 ミクロン程度の厚みを値えており、その裏面に図 示しない長手状の凹陥部が形成されることにより、 厚みが数乃至十数ミクロンの薄肉部68が長手状 に形成されている。この薄肉部58には、たとえ ば本出願人が先に出顧した特願平2-2293号 の明細書および図面に記載されているように、不 純物の拡散あるいは注入などの良く知られた半導 体製造手法を用いて形成された4つの歪抵抗素子 を有するブリッジから成り、接触圧を検知するた めの複数の感圧素子70が一方向に沿って所定間 隔毎に配列されている。 脈波センサ 3 0 は、これ ら感圧素子70が動脈35の真上に位置し且つそ



れらの配列方向が動脈35と直交する姿勢で生体の皮膚に押圧され、これにより、各怒圧素子70からは、薄肉部66に加えられた歪に対応した電気信号、すなわち感圧素子70に作用する圧力変動である前記圧脈波を表す脈波信号が出力される。

 且つ他方がスペーサ5 8 の個壁面に沿った姿勢とされ、その両端部が半導体チップ6 6 の端子7 6 および回路膜 5 2 の端子7 8 にそれぞれ半田接着されている。すなわち、フレキシブルフラットケーブル8 4 は、スペーサ5 8 の側壁面に沿って、板部材5 6 から垂直に立ち上がった状態で配設されているのである。

そして、スペーサ 5 8 の周囲であっトケーンは、スペーサ 5 8 の周囲であっトケーンは、フレキシブルフラットケーンははでアイソレーの 8 6 が設けられるとと、は、はずでに、ははずなとという。とはずないよりを続されている。とは、サ 5 8 の周囲に保護でいる。というの表面には、スペーサ 5 8 の周囲に保護でした。というの表面には、スペーサ 5 8 の周囲に保護でした。というの表面には、スペーサ 5 8 の周囲に保護でした。というの表面には、大切の関連には、大切の関連には、大切の関連には、大切ののは、大切ののでは、大切のでは、大りのでは、大切のでは、大りのでは、大切のでは、大りのでは、大切のでは、大りのでは、いりのでは、大りのでは、大りのでは、大りのでは、大りのでは、いりのでは、大りのでは、大りのでは、大りのでは、

の表面には、絶縁のための樹脂製アイソレーションシール暦 9 4 が塗布されている。なお、9 6 はセンサチップ 6 0 とスペーサ 5 8 との間の接着層であり、9 8 は保護プレート 6 2 とセンサヘッドケース 5 0 との間の接着層である。接着層には、繋外線硬化樹脂が好適に用いられる。

 加えられたり、或いは温度変化があったとしても、 半導体チップ 6 6 に歪が発生することが防止され るので、測定精度が影響されず、圧脈波が正確に 測定されるのである。

また、本実施例によれば、半導体チップ66が 遮光層として機能する黒色導電性ゴム層92によ り頂われているので、半導体チップ66の薄肉部 68に設けられた感圧素子70に対する光の影響 が解消され、測定精度が大幅に高められるととも に、黒色導電性ゴム圏92によって静電気の影響 が抑制される。

また、本実施例によれば、保護プレート62が接地されていることからガードリング機能が備えられており、たとえば電気メスなどによる高周被ノイズによる影響を好通に抑制することができる。 ・以上、本発明の一実施例を図面に基づいて説明 したが、本発明はその他の態様においても適用さ

たとえば、前述の実施例において、半導体チップ 6 6 には、複数の感圧素子 7 0 が設けられてい





たが、1個であってもよいのである。

また、前述の実施例のフレキシブルフラットケ ーブル84には、板部材56と平行な部分が設け られていたが、回路膜52から直接に立ち上げら れていてもよいのであり、また、若干傾斜して略 垂直に立ち上げられても一応の効果が得られるの である.

また、前述の実施例では、板部材56の一面に 回路膜52が固着されることにより基板が構成さ れていたが、一面に厚膜導体が配線されたセラミ ック板などであってもよいのである。

また、前述の実施例では、感圧素子70が長手 状の薄肉部68に所定間隔毎に設けられていたが、 個々の独立した凹陥部の薄肉部に窓圧素子が設け られてもよいのである。

また、前述の半導体チップ66にはシリコン単 結晶板が用いられていたが、ガリウムー砒素など の化合物半導体の単結晶板が用いられてもよい。

また、前述の実施例では、感圧素子70は半導 体歪抵抗素子を有して構成されているが、感圧ダ イオードや感圧トランジスタなどにて構成されて もよい。

また、前述の実施例は、橈骨動脈35の脈波を 検出するための手首34に装着される形式の脈波 検出用プロープについて説明されていたが、頸動 脈や足骨動脈に対して適用されるものであっても よいのである.

なお、上述したのはあくまでも本発明の一実施 例であり、本発明はその主旨を逸脱しない範囲で 種々変更が加えられ得るものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、第4図の脈波センサをさらに拡大し て示す図である。第2図は本発明の脈波センサを 含む脈波検出用プローブの装着状態を示す図であ る。第3図は第2図の脈波検出用プローブを手首 側から見た図である。第4図は、第2図および第 3 図の脈波検出用プローブ内に儲えられた脈波セ ンサの構成を説明する新面図である。第5図は、 第4図のセンサチップの構成を説明する斜視図で ある.

30: 脈波センサ (接触圧センサ)

35: 撓骨動脈

5 2 : 回路膜

(基板) 56: 板部材

5 B: スペーサ

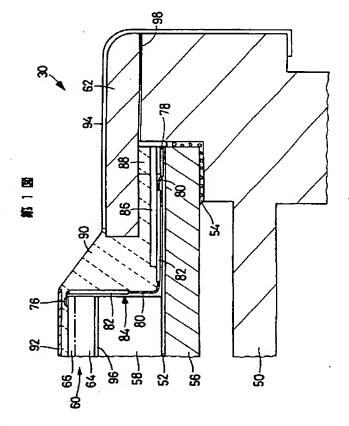
66: 半導体チップ

8 4:フレキシブルフラットケーブル

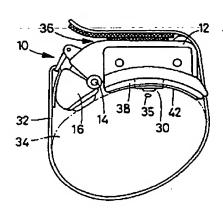
出願人 コーリン電子株式会社

代理人 弁理士 池 田 治

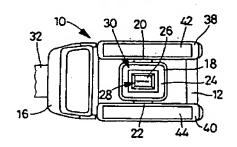
(ほか2名)

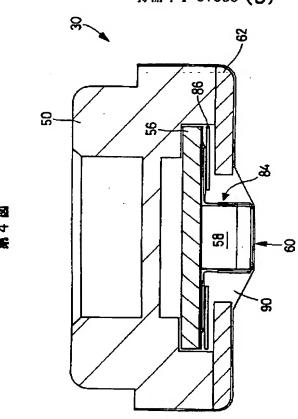




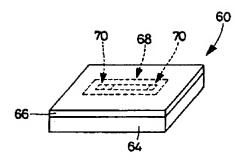


第3図





第 5 🖸



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

₩ BLACK BORDERS	
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
☑ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
OTHER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.